

平成28年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

平成28年4月5日  
京都府中小企業技術センター  
担当：応用技術課 東技師  
TEL：075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる基盤技術として接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした「京都実装技術研究会」を毎年開催しています。

このたび、広く会員を募集するためにオープニングセミナー（無料）を下記のとおり開催します。

記

1 日 時

平成28年4月27日（水） 午後1時30分 ～ 午後4時30分

2 場 所

京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）研修室 5階

3 内容及び講師

- (1) 「世界最小0201サイズ チップ積層セラミックコンデンサの実用化」  
株式会社福井村田製作所 第1コンデンサ技術戦略企画部 実装設計課  
エキスパート 加藤 俊一 氏

講師は、次世代の超小型サイズとして0.25mm×0.125mmの積層セラミックコンデンサの実用化に携わってこられました。寸法設定を含め商品コンセプト及び商品化に必要な技術取り組みに加えて、市場での採用促進に向けた実装技術の環境整備状況をお話しいたします。

- (2) 「0201チップ実装から超大型多層基板実装の温度プロファイル作成方法」  
「フラックスの特性評価と温度プロファイルの作成」他  
実装技研 実装技術アドバイザー 河合 一男 氏

講師は、当センターに設置されているリフロー装置を用いた実装技術に関する実験に携わってこられました。その温度プロファイル等についてご説明いたします。

4 定 員

70名（先着順・定員になり次第、締切らせていただきますのでご了承ください。）

5 申込締切日

平成28年4月25日（月）まで

6 申込先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当  
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497  
E-mail jisso@mtc.pref.kyoto.lg.jp